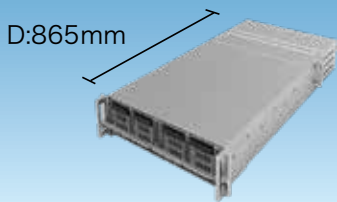


高密度実装 HPC サーバー

HPC5000-XCA2UTwin

第2世代インテル® Xeon® Platinum 9200(Cascade Lake-AP) シリーズ搭載

科学技術計算、分析インフラに適した 2U/2 ノード CPU192 コア・最大6TB メモリ高密度サーバー



特長

- 第2世代インテル® Xeon® Platinum 9200(Cascade Lake-AP) シリーズを採用
- 2U ラックマウント筐体に 2 ノード (最大 192 コア) 収納
- 1 ノードあたり 3TB メモリまで搭載可能
- 安定的な運用を確保する冗長化電源を搭載 (80PLUS TITANIUM 認証取得 2+1 リダンダント電源)
- PMI2.0 を標準搭載、追加オプションにてリモート KVM、リモートメディアリダイレクションに対応 (高負荷時の騒音レベルは 75dB になるため、防音対策をお願い致します)



製品仕様

第2世代インテル® Xeon® Platinum 9200(Cascade Lake-AP) シリーズ搭載

高い演算能力が求められるハイパフォーマンスコンピューティング (HPC)、人工知能 (AI)、サービスとしてのインフラストラクチャ (IaaS) の負荷に対応するように設計された、第2世代インテル® Xeon® Platinum 9200(Cascade Lake-AP) シリーズ 最大 2CPU (96 コア) を搭載。インテル® Xeon® Platinum 9242 を選択することで、1 ノード最大 96 コアまで実装することができます。
(高負荷時の騒音レベルは 75dB になるため、防音対策をお願い致します)

1 ノードあたり最大 3TB メモリ搭載可能

DDR4-2933 対応メモリスロットを 1 ノードあたり 24 本搭載しています。128GB メモリモジュールを使用することで最大 3TB のメモリ容量を確保することができます。
(※ メモリ搭載枚数は 8、16、24 枚構成のみ対応)

2 つの Cascade Lake-SP のダイを 1 パッケージ化された Cascade Lake-AP(Advanced Performance)

2 つの Cascade Lake のダイを 1 パッケージ化、CPU 間を UPI(10.4GT/s) 相互接続する事で低レイテンシでの通信を実現。

すべてのインテル® Xeon® プロセッサ・プラットフォームの中で最大のメモリ帯域幅 (281GB/s) をサポート

DDR4-2933 対応メモリスロットを 24 本搭載しています。DDR4-2933 LRDIMM 128GB メモリモジュールを使用することで最大 3TB のメモリ容量を確保することができます。

24 チャンネルアクセスにより 281GB/s とリリース時点ですべてのインテル® Xeon® プロセッサ・プラットフォームの中で最大のメモリ帯域幅をサポートします。

高い変換効率を誇る 80PLUS TITANIUM 認証取得電源を搭載

80PLUS 認証とは、交流から直流への変換効率を保証するものです。80PLUS 認証とは、交流から直流への変換効率を保証するものです。80PLUS TITANIUM 認証は、負荷率 20% /50% /100% でそれぞれ 94% /96% /91% という高い変換効率基準をクリアしたものに与えられます。

冗長化電源搭載による高い障害耐性

200V 環境で 1600W の電源ユニットを 3 個搭載しています。
総消費電力数が 2 個の電源ユニットで収まる構成であれば、一方の電源ユニットに障害が発生した場合でもサーバーの運転を継続するための電力を充分に供給できる冗長性を持っています。これにより万が一の電源ユニット障害によるダウンタイムを最小限に抑えることが出来ます。

IPMI2.0 機能を標準搭載、追加オプションにてリモート KVM、リモートメディアリダイレクションに対応

標準搭載された IPMI2.0 機能によりリモート環境下でサーバーのシステム管理が可能なおことに加え、追加オプションの KVM モジュールと搭載することによりリモート KVM やリモートメディアリダイレクションに対応、リモート環境から各種メディアからのソフトウェアセットアップなどの作業も可能です。

これらの機能によりシステムの信頼性、可用性を高め、ダウンタイムとメンテナンス費用を圧縮することを可能にします。

製品名	HPC5000-XCA2UTwin
OS	Ubuntu 18.04 LTS Red Hat Enterprise Linux 7.6 x86_64 CentOS 7.6 x86_64
プロセッサ	Platinum 9242 (48 コア,96 スレッド,2.3GHz,TDP350W) または Platinum 9221 (32 コア,64 スレッド,2.3GHz,TDP250W) ※各ノードあたり 2 基搭載
プロセッサ搭載数 per node	最大 2CPU (96 コア)
プロセッサ冷却方式	空冷式
チップセット	インテル® C621
メモリ per node	(per node) 3.0TB (128GB DDR4-2933 ECC LRDIMM × 24) 1.5TB (64GB DDR4-2933 ECC LRDIMM × 24) 768GB (32GB DDR4-2933 ECC Registered × 24) 384GB (16GB DDR4-2933 ECC Registered × 24) 192GB (8GB DDR4-2933 ECC Registered × 24) ※メモリ性能を重視される場合、メモリモジュールを 24 枚単位で搭載する構成を推奨します。
メモリスロット per node	24DIMM スロット (1CPU あたり 12 スロット) DDR4-2933 ECC LRDIMM (64GB,128GB) DDR4-2933 ECC Registered (8,16,32GB) ※メモリ搭載枚数は 8、16、24 枚構成のみ対応
SSD 搭載数 per node	標準 : 480GB (SATA 6Gbps M.2) × 2 ※ 2.5 型 U.2 NVMe SSD を最大 2 台搭載可能 ※ M.2 SATA/NVMe SSD を最大 2 台搭載可能
光学ドライブ	なし
グラフィックス per node	Aspeed AST2500 BMC (I/O breakout ケーブルにて引き出し VGA 出力)
インターフェイス per node	I/O breakout (前面) × 1 ※ケーブル引き出し (シリアルポート、VGA 出力、USB2.0 × 2) USB3.0 (前面 × 1) ネットワーク [GbE ポート] (前面) × 1 IPMI2.0 ポート [RJ45] (前面) × 1
拡張スロット per node	PCI-Express 3.0 (x16) × 2
電源ユニット	200V 環境 1600W × 3 (80PLUS TITANIUM 認証取得 2+1 リダンダント電源) 総消費電力が 3200W(200V) 内のみ冗長化可能です。
AC ケーブル	200V 用 AC ケーブルを 3 本添付 / IEC320-C13 ⇒ IEC320-C14
AC コネクタタイプ	IEC320-C14
最大消費電力 per node	986W
筐体タイプ	ラックマウントタイプ (2U)
サイズ (縦幅×横幅×奥行)	86.8mm × 442mm × 865mm (突起物除く)
重量	47.64kg (ケース+モジュール合算)
付属品	200V 用 AC ケーブル × 3 USB キーボード (日本語または英語) × 1 USB 光学式スクロールマウス × 1 取扱説明書 保証書
オプション	インテル® イーサネット・ネットワーク・アダプター (10GbE) Mellanox インフィニバンド HCA (25GbE, 50GbE, 100GbE) 2.5 型 SSD (フラッシュメモリドライブ) M.2 型 SSD (フラッシュメモリドライブ) 各種ディスプレイ
保証	3 年間センドバック保守

販売店	
-----	--



HPC システムズ株式会社
〒108-0022 東京都港区海岸 3-9-15 LOOP-X 8 階
TEL : 03-5446-5531 FAX : 03-5446-5550
Mail : hpcs_sales@hpc.co.jp

- この内容は、2020年7月21日現在の内容です。
- 価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。商品の色調は実際と異なる場合があります。
- 社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。
- Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。

